

## LSF-SMT 5.08/03/90 3.5SN BK TU SO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

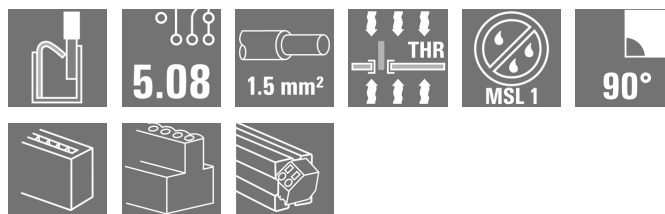
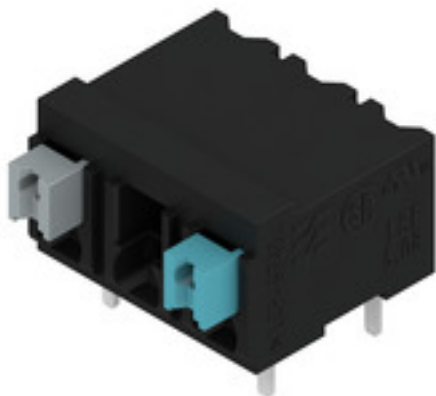
Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



リフローはんだの全自動組立対応プリント基板端子 (SMT)、プッシュイン導体接続システム搭載。電線挿入方向とスライダ操作 (TOP)。箱梱包 (BX) または静電気防止テープオンリール梱包 (RL) 1.5 mm または 3.5 mm で調整されたピンの長さ。

## 一般注文データ

バージョン	プリント基板端子台, 5.08 mm, 極数: 3, 90°, ソルダピン長 (l): 3.5 mm, 黒色, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 1.5 mm², Tube
注文番号	<a href="#">2738750000</a>
種別	LSF-SMT 5.08/03/90 3.5SN BK TU SO
GTIN (EAN)	4050118828504
数量	38 Stück
製品データ	IEC: 630 V / 0.2 - 1.5 mm² UL: 300 V / 12 A / AWG 28 - AWG 14
パッケージ	Tube

作成日 2024/07/02 6:09:08 CEST

## LSF-SMT 5.08/03/90 3.5SN BK TU SO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	14.75 mm	奥行き (インチ)	0.581 inch
高さ	12 mm	高さ (インチ)	0.472 inch
下位バージョンの高さ	8.5 mm	幅	14.36 mm
幅 (インチ)	0.565 inch	正味重量	1.84 g

## 温度

連続動作温度、最大	120 °C
-----------	--------

## システムパラメータ

製品ファミリー	OMNIMATEシグナル - シリーズLSF	導体接続方法	アクチュエータ付プッシュイン
PCB の取り付け	THT/THRはんだ接続	導体取り出し方向	90°
ピッチ (mm) (P)	5.08 mm	ピッチ (インチ) (P)	0.2 "
極数	3	ピンモデルシリーズ数量	1
行数	1	ソルダーピン長 (l)	3.5 mm
はんだピン寸法	0.35 x 0.8 mm	L1 (mm)	10.16 mm
L1 (インチ)	0.4 "	保護度合い	IP30, 完全取付け時

## 材料データ

絶縁材	LCP GF	色	黒色
カラーチャート (類似)	RAL 9011	Moisture Level (MSL)	1
UL 94 可燃性等級	V-0	接点材質	銅合金
はんだ接続の層構造	4...6 µm Sn matt	保管温度、最小	-40 °C
保管温度、最大	70 °C	動作温度、最小	-50 °C
動作温度、最大	120 °C		

## 接続に適した導体

クランプ範囲、最小	0.13 mm <sup>2</sup>
クランプ範囲、最大	1.5 mm <sup>2</sup>
固定式、最小 H05 (07) V-U	0.2 mm <sup>2</sup>
固定式、最大 H05 (07) V-U	1.5 mm <sup>2</sup>
フレキシブル、最小 H05 (07) V-K	0.2 mm <sup>2</sup>
フレキシブル、最大 H05 (07) V-K	1.5 mm <sup>2</sup>
w. プラスチックカラーフェルール、DIN 0.25 mm <sup>2</sup> 46228 pt 4、最小	
プラスチックカラー付フェルール DIN 0.75 mm <sup>2</sup> 46228 pt 4、最大	
w. フェルール、DIN 46228 pt 1、最小 0.25 mm <sup>2</sup>	
ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228 1.5 mm <sup>2</sup> pt 1、最大	

## LSF-SMT 5.08/03/90 3.5SN BK TU SO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

クランプ導体	導体接続断面	公称	0.25 mm <sup>2</sup>
	フェルール端子	被覆剥き長さ	公称 10 mm
		推奨フェルール端子	<a href="#">H0.25/12 HBL</a>
	導体接続断面	公称	0.34 mm <sup>2</sup>
	フェルール端子	被覆剥き長さ	公称 10 mm
		推奨フェルール端子	<a href="#">H0.34/12 TK</a>
	導体接続断面	公称	0.5 mm <sup>2</sup>
	フェルール端子	被覆剥き長さ	公称 10 mm
		推奨フェルール端子	<a href="#">H0.5/14 OR</a>
	導体接続断面	公称	0.75 mm <sup>2</sup>
	フェルール端子	被覆剥き長さ	公称 10 mm
		推奨フェルール端子	<a href="#">H0.75/14T HBL</a>

導体接続断面	公称	1 mm <sup>2</sup>
	被覆剥き長さ	公称 12 mm
	推奨フェルール端子	<a href="#">H1.0/16D R</a>
	推奨フェルール端子	<a href="#">H1.5/16 R SV</a>


導体接続断面	公称	1.5 mm <sup>2</sup>
	被覆剥き長さ	公称 12 mm
	推奨フェルール端子	<a href="#">H1.5/16 R SV</a>
	推奨フェルール端子	<a href="#">H1.5/16 R SV</a>

参照テキスト フェルールの長さは、製品と定格電圧に応じて選択されます。、プラスチック製カラーの外径はピッチ (P) より大きくできません


## IEC規格に準拠した公称データ

定格電流、最大極数 (Tu=20°C)	17.5 A	定格電流、最小極数 (Tu=40°C)	17.5 A
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 II/2	630 V	サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/2	630 V
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 II/2	4 kV	サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/2	6 kV

## CSAに準拠した公称データ

試験制度 (CSA)		証明書番号 (CSA)	200039-1664286
定格電圧 (グループ B/CSA 使用)	300 V	定格電圧 (グループ D/CSA 使用)	300 V
定格電流 (グループ B/CSA 使用)	10 A	定格電流 (グループ D/CSA 使用)	10 A
導体断面積、AWG、最小	AWG 28	導体断面積、AWG、最大	AWG 14
認可値の参照	仕様は最大値です - 詳細については承認証明書を参照してください。		

## UL 1059に準拠した公称データ

設定 (cURus)		証明書番号 (cURus)	E60693
定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用)	300 V	定格電圧 (グループ D / UL 1059 使用)	300 V
定格電流 (グループ B / UL 1059 使用)	12 A	定格電流 (グループ D / UL 1059 使用)	10 A
導体断面積、AWG、最小	AWG 28	導体断面積、AWG、最大	AWG 14
承認値への参照	仕様は最大値です - 詳細については承認証明書を参照してください。		

## 梱包

パッケージ	Tube	VPE 長	557 mm
VPE幅	21 mm	VPEの高さ	15 mm

作成日 2024/07/02 6:09:08 CEST

## LSF-SMT 5.08/03/90 3.5SN BK TU SO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## テストの種類

試験：マーキングの耐久性	テスト	原産地表示, 種類の識別, ピッチ, 承認マーキング UL, 耐久性
	評価	使用可能
テスト：クランプ可能な断面	標準	DIN EN 60999-1セクション7および9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1セクション8.2.4.5.1 / 12.02
	導体種類	導体の種類と導体断面 固定式0.14 mm <sup>2</sup>
		導体の種類と導体断面 撚線0.14 mm <sup>2</sup>
		導体の種類と導体断面 固定式1.5 mm <sup>2</sup>
		導体の種類と導体断面 撚線1.5 mm <sup>2</sup>
		導体の種類と導体断面 AWG 24/1
		導体の種類と導体断面 AWG 24/19
		導体の種類と導体断面 AWG 16/1
		導体の種類と導体断面 AWG 16/19
	評価	合格した
導体の損傷や偶発的な緩みをテストする	標準	DIN EN 60999-1セクション9.4 / 12.00
	要件	0.2 kg
	導体種類	導体の種類と導体断面 AWG 28/1
		導体の種類と導体断面 AWG 28/19
	評価	合格した
	要件	0.3 kg
	導体種類	導体の種類と導体断面 撚線0.25 mm <sup>2</sup>
		導体の種類と導体断面 固定式0.5 mm <sup>2</sup>
	評価	合格した
	要件	0.4 kg
引き抜き試験	標準	導体の種類と導体断面 固定式1.5 mm <sup>2</sup>
		導体の種類と導体断面 撚線1.5 mm <sup>2</sup>
	導体種類	導体の種類と導体断面 AWG 16/1
		導体の種類と導体断面 AWG 16/19
	評価	合格した
	要件	≥10 N
	導体種類	導体の種類と導体断面 AWG 24/1
		導体の種類と導体断面 AWG 24/19
	評価	合格した
	要件	≥20 N
	導体種類	導体の種類と導体断面 撚線0.25 mm <sup>2</sup>
		導体の種類と導体断面 H05V-U0.5
	評価	合格した
	要件	≥40 N
	導体種類	導体の種類と導体断面 H07V-U1.5
		導体の種類と導体断面 H07V-K1.5
		導体の種類と導体断面 AWG 16/1
		導体の種類と導体断面 AWG 16/19
	評価	合格した

## 分類

ETIM 6.0	EC002643	ETIM 7.0	EC002643
ETIM 8.0	EC002643	ETIM 9.0	EC002643
ECLASS 9.0	27-44-04-01	ECLASS 9.1	27-44-04-01
ECLASS 10.0	27-44-04-01	ECLASS 11.0	27-46-01-01
ECLASS 12.0	27-46-01-01	ECLASS 13.0	27-46-01-01

作成日 2024/07/02 6:09:08 CEST

## LSF-SMT 5.08/03/90 3.5SN BK TU SO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC

/

## 重要なメモ

IPC準拠

適合性：製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。

注意事項

• 平均温度 50 °C、最大湿度 70%、36ヶ月の長期保存が可能

## 承認

認可



UL File Number Search

UL ウェブサイト

証明書番号 (cURus)

E60693

## ダウンロード

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

製品変更通知

[Capacity expansion of LSF-SMT stamping tools](#)  
[Kapazitätserweiterung der Stanzwerkzeuge LSF-SMT](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

ホワイトペーパーの表面取り付け技術

[Download Whitepaper](#)

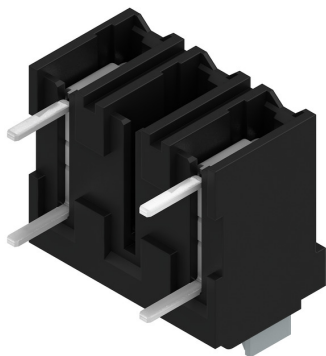
# LSF-SMT 5.08/03/90 3.5SN BK TU SO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

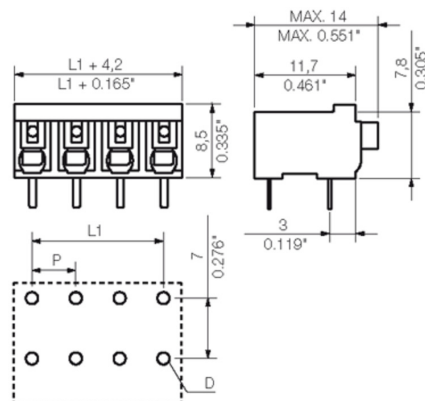
www.weidmueller.com

## 図面

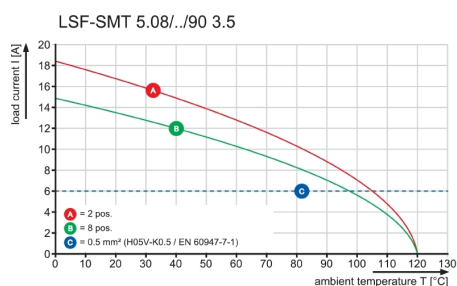
### 製品イメージ



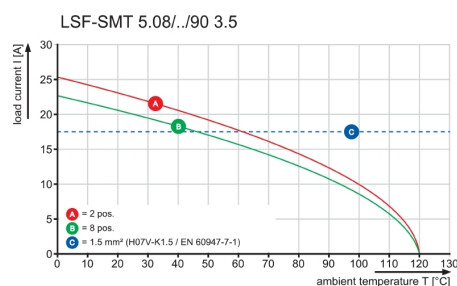
### 寸法図



### グラフ



### グラフ



## LSF-SMT 5.08/03/90 3.5SN BK TU SO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## スクリュードライバー (マイナス用)



丸刃の付いたマイナススクリュードライバー SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264, ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリップ

## 一般注文データ

種別	SDS 0.4X2.5X75	バージョン
注文番号	<a href="#">9009030000</a>	スクリュードライバー, スクリュードライバー
GTIN (EAN)	4032248266944	
数量	1 Stück	

## スクリュードライバー (マイナス用)



VDE 絶縁マイナススクリュードライバー、SDI DIN 7437、ISO 2380/2、DIN 5264、ISO 2380/1 準拠ドライバー出力。ソフトフィニッシュグリップ

## 一般注文データ

種別	SDIS 0.4X2.5X75	バージョン
注文番号	<a href="#">9008370000</a>	スクリュードライバー, スクリュードライバー
GTIN (EAN)	4032248056330	
数量	1 Stück	

## Recommended wave soldering profiles

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Single Wave:



### Double Wave:



### Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.



## Recommended reflow soldering profile

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



## Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically  $\leq +3\text{K/s}$ . In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at  $\geq -6\text{K/s}$  solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.